



先進パワー半導体ウェハ加工技術に関する専門展示会
SiC, GaN加工技術展 2025

2展示会 同時開催

硬質・難削材料ウェーハの高効率加工

硬脆材料ウェーハ研削盤 **DDT832**



JTEKT ジェイテクトマシンシステム
JTEKT MACHINE SYSTEMS CORPORATION



出展のご案内

**SiC, GaN加工技術展
2025**

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社はこのたび「Grinding Technology Japan 2025」及び、「SiC, GaN加工技術展 2025」へ
出展いたしますのでご案内申し上げます。

今回は、

「Grinding Technology Japan 2025」では、立形研削盤VGF300の実機展示、

「SiC, GaN加工技術展 2025」では、硬脆材料ウェーハ研削盤DDT832を展示致します。

この機会に是非、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

敬具

2025年1月吉日

株式会社ジェイテクトマシンシステム
代表取締役社長 宮藤 賢士

開催概要・出展位置

開催期間:3月5日(水)～7日(金)

開催時間:10:00～17:00

会 場 :幕張メッセ 展示ホール8

出展位置:**G-101**(Grinding Technology Japan 2025)

S-47 (SiC, GaN加工技術展 2025)

共同出展:(株)ジェイテクト、(株)ジェイテクトグライディングツール、三井精機工業(株)

**GTJ2025
期間中開催**

なんでも相談室

あらゆる研削に対応

センタレスも平面も専用機も
お客様に最適な研削盤・研削技術をご提案



JTEKT 株式会社ジェイテクトマシンシステム